

標準作業程序：

1. 使用前先檢查機台狀況，確定機台目前使用情形（綠牌：使用中、紅牌：維修中、黃牌：測試中）。確認機台操作螢幕之機台狀態為：cold idle
2. 確認操作螢幕無顯示任何警告訊息。
3. 按 “PSET” 功能按鈕，執行 leakage check，若腔體壓力保持 10mtorr 以下，表示機台無漏氣疑慮，可執行後續動作。
4. 按 “recipe” manu, 執行 startup, 讓機台自動昇溫至 900 度，並處於 warm idle 狀態。
5. 打開 loadlock 腔室，將經過標準清洗後的晶圓置於 cassette, 關閉腔門，執行 “prepare” 功能，等待 loadlock 處於 standby 狀態。
6. 將設定好的磊晶 recipe 指定給目標晶圓，確認無誤後，按 “auto” 或 “manual” 按鈕，即可執行自動模式或手動模式磊晶製程。
7. “recipe” 執行完畢後，機台可將晶圓自動傳輸至 loadlock 腔室。
8. 關閉 transfer chamber 與 loadlock chamber 之間閥門，然後破真空打開 loadlock 取出磊晶後的晶圓。
9. 關閉 loadlock 腔們，執行 “prepare” 功能。機台再次處於 warm idle 狀態，等待執行下一批次磊晶，或執行 “shutdown” 功能使機台處於 cold idle 狀態。